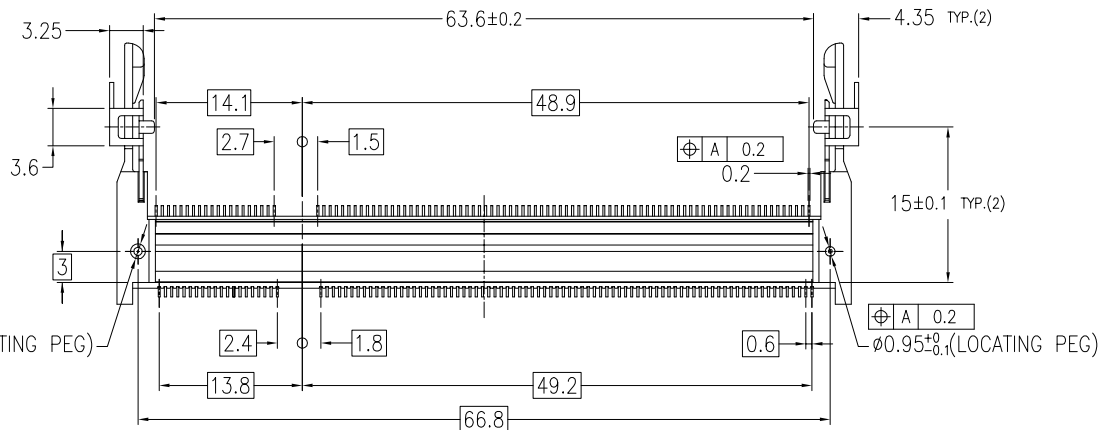
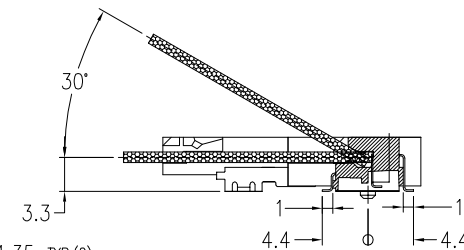
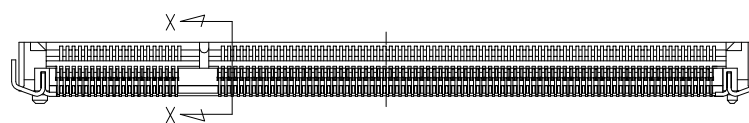
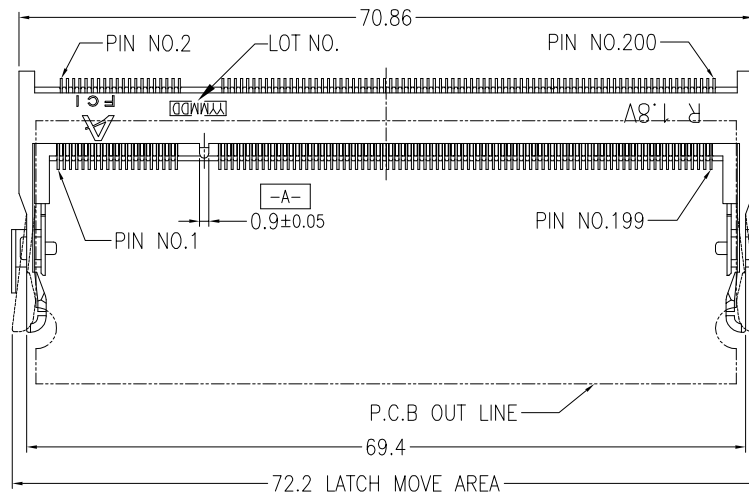
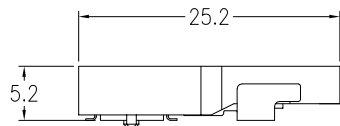


PRODUCT NO.
10033854-*52**



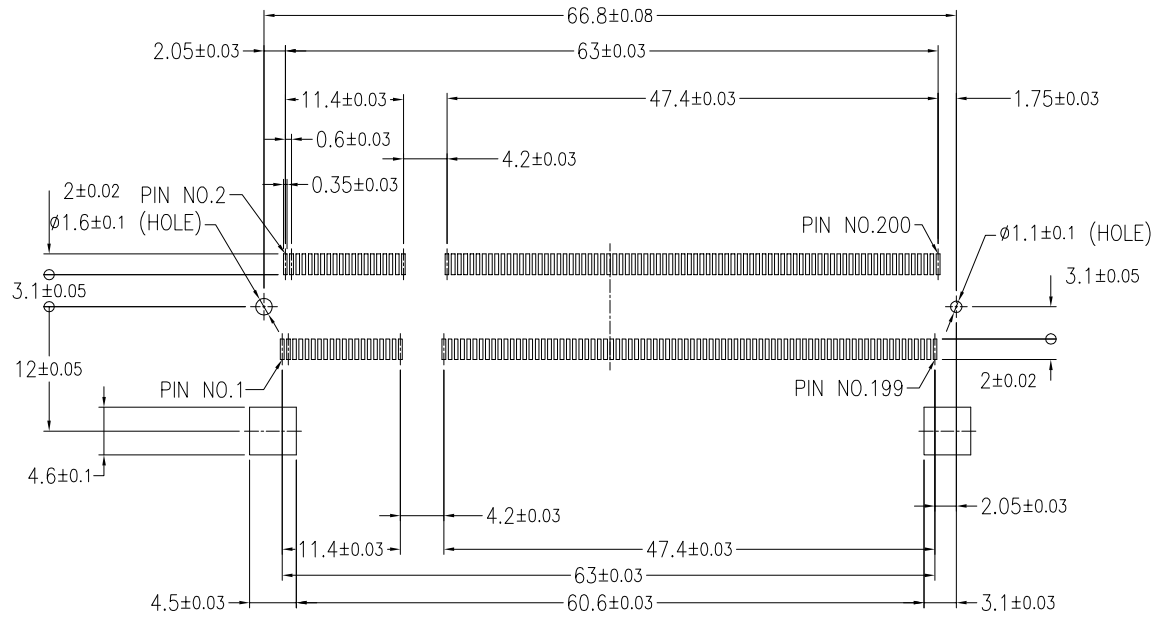
NOTE

1. PRODUCT SPEC. : GS-12-195
2. PACKAGING SPEC. : GS-14-786
3. MATERIAL
 - 1) HOUSING : LCP, UL94V-0, COLOR BLACK
 - 2) CONTACT : COPPER ALLOY
 - 3) HOLD DOWN : BRASS
4. FINISH
 - 1) TERMINAL : SEE TABLE
 - 2) HOLD DOWN : SEE TABLE
5. CO-PLANARITY : 0.1 MAX.(INCLUDE HOLD DOWN)
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDER APPLICATION.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI	
ltr	ecn no	dr	date					projection		title	www.fciconnect.com
2		M H	8/28/'03	linear	.X ± 0.20			⊕		DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y	
3		M H	4/2/'04		.XX ± 0.10						
4		M H	6/29/'04	angles	0° ± 5°						
A	J04-0401	M H	9/28/'04	dr	M.Hasegawa	6/29/'04		MM		product family 50UF SO-DIMM	code JP
B	T05-0022	R C	11/9/'04	enr	M.Hasegawa	6/29/'04				size dwg no	sheet 1 of 4
C	T05-0229	R C	10/12/'05	chr				scale			
D	pg08-0333	B L	12/1/'08	appd				2:1			
sheet	revision	D	D	D	D						
index	sheet	1	2	3	4						



PRODUCT NO.
10033854-*52**



RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		www.fciconnect.com			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20	projection		title DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y			
D					.XX ± 0.10						
				angles	0° ± 5°			product family 50UF SO-DIMM size dwg no			
				dr	M.Hasegawa	6/29/04	MM				
				enr	M.Hasegawa	6/29/04	scale	B 10033854			
				chr			2:1				
				appd				code JP sheet 2 of			
sheet index	revision sheet										



PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
10033854-052FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Au FLASH
10033854-152FSLF	NO			
10033854-052TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TSLF	NO			
10033854-052ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-152ASLF	NO			
10033854-052FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-152FB	NO			
10033854-052TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TB	NO			
10033854-052AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-152AB	NO			
10033854-252FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Pure Sn PLATING
10033854-352FSLF	NO			
10033854-252TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TSLF	NO			
10033854-252ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352ASLF	NO			
10033854-252FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-352FB	NO			
10033854-252TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TB	NO			
10033854-252AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352AB	NO			
10033854-452FS	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Sn-Pb PLATING
10033854-552FS	NO			
10033854-452TS	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TS	NO			
10033854-452AS	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AS	NO			
10033854-452FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-552FB	NO			
10033854-452TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TB	NO			
10033854-452AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AB	NO			

10033854-□□□□□ LF

<PACKING METHOD>
R : TAPE REEL
DEFAULT : TRAY

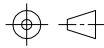
<HOLD DOWN FINISH>
S : Pure Sn
B : Sn-Pb
<CONTACT AREA FINISH>
F : Au FLASH
T : Au 0.3um MIN.
A : Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>
52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>
0 : YES, Au FLASH
1 : NO, Au FLASH
2 : YES, Pure Sn PLATING
3 : NO, Pure Sn PLATING
4 : YES, Sn-Pb PLATING
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.
EX: 10033854-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:
THIS "LF" CODE IS "BLANK".
EX:10033854-452TS

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com							
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20	projection		title							
D					.XX ± 0.10			DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y							
				angles	0° ±5°			product family 50UF SO-DIMM							
				dr	M.Hasegawa 6/29/04	MM		size dwg no							
				engr	M.Hasegawa 6/29/04			code JP							
				chr		scale	2:1	sheet 4 of							
				appd				B 10033854							
sheet index	revision sheet														

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9